



MicroVision e STMicroelectronics promuoveranno insieme soluzioni di scansione laser basate su specchi MEMS

Le due aziende si rivolgono alle applicazioni di pico-proiezione, realtà virtuale e aumentata (VR, AR) sensoristica 3D e ADAS

Redmond (Washington, USA) e Ginevra (Svizzera) – 10 novembre 2016 – [MicroVision, Inc.](#), leader negli schermi innovativi per proiezioni ultra-miniaturizzate e nella sensoristica, e [STMicroelectronics](#), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, hanno annunciato oggi di avere in programma di lavorare insieme per sviluppare, vendere e promuovere sul mercato la tecnologia a scansione laser (Laser Beam Scanning, LBS).

Le aziende prevedono di collaborare strettamente per lo sviluppo del mercato, realizzando tra l'altro iniziative congiunte di marketing e vendita per soluzioni LBS. Oltre ai settori della pico-proiezione e degli schermi heads-up (HUD) a cui entrambe le aziende stanno attualmente proponendo le proprie soluzioni LBS, ST e MicroVision prevedono di rivolgersi a nuovi mercati e applicazioni emergenti tra cui realtà virtuale e aumentata (VR, AR), sensoristica 3D, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Inoltre, MicroVision e ST prevedono di esplorare opzioni di collaborazione sullo sviluppo tecnologico futuro, compresa una roadmap congiunta di prodotti LBS. Questa cooperazione unisce l'esperienza di progettazione di processo e produzione di ST con quella di MicroVision nelle soluzioni e nei sistemi LBS.

“Lavorando con MicroVision, ci siamo posti l'obiettivo di mettere a frutto le nostre competenze complementari, la visione condivisa e l'impegno a far crescere i mercati che utilizzano l'LBS e aprire molte opportunità per entrambe le aziende,” ha detto Benedetto Vigna, Executive Vice President del Gruppo Analogici e MEMS di ST. “Questa collaborazione metterà ST nella posizione di poter cogliere tutte le opportunità di crescita per l'LBS e i componenti complementari di potenza, sensoristica e controllo.”

“Fare squadra con ST, leader mondiale in questo settore, è importante per MicroVision sia per l'esperienza di ST nella tecnologia a semiconduttore sia per la sua capacità di

raggiungere clienti in ogni parte del mondo,” ha affermato Alexander Tokman, president & CEO di MicroVision. “La combinazione dell’esperienza di ST nello sviluppo e produzione di componenti chiave per i motori di scansione LBS con il sistema proprietario, il motore, la conoscenza applicativa e la proprietà intellettuale di MicroVision può rappresentare un enorme vantaggio per il marketing di soluzioni LBS nei confronti di molte aziende e per un grande numero di applicazioni.”

Le società hanno già in corso una collaborazione operativa per la produzione di componenti MicroVision. ST produce l’attuale generazione di *die* MEMS di MicroVision basati su progetto di MicroVision. ST produce anche uno degli ASIC venduti da MicroVision.

Alcune informazioni su MicroVision

MicroVision è il creatore della tecnologia di scansione PicoP®, una soluzione ultra miniaturizzata di sensoristica e proiezione laser basata sulla metodologia di scansione laser di cui la società è pioniere. L’approccio di MicroVision per questa avanzata soluzione di sensoristica e visualizzazione prevede la definizione di una piattaforma che può essere adattata a una vasta gamma di applicazioni con differenti fattori di forma. È una soluzione avanzata per un mondo sempre connesso e in rapida evoluzione. Una intensa attività di ricerca ha permesso a MicroVision di diventare leader indipendente e riconosciuto nello sviluppo di proprietà intellettuale. Il portafoglio di IP di MicroVision è stato riconosciuto dall’Ufficio Brevetti USA come uno dei 50 più significativi portafogli di IP tra le aziende industriali globali ed è stato inserito nell’Ocean Tomo 300 Patent Index. La società ha sede a Redmond, Washington.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito della società www.microvision.com, o Facebook www.facebook.com/MicroVisionInc o di seguire MicroVision su Twitter [@MicroVision](https://twitter.com/MicroVision).

MicroVision e PicoP sono marchi registrati di MicroVision, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi aventi diritto.

Alcune informazioni su STMicroelectronics

ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni intelligenti e efficienti dal punto di vista del consumo di energia che danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano. I prodotti ST si trovano già oggi dappertutto e saranno ancora più diffusi domani perché, insieme ai nostri clienti, lavoriamo per rendere sempre più intelligenti le automobili, le fabbriche, le città e le abitazioni, oltre ai dispositivi mobili e di Internet of Things.

Ed è proprio perché ST lavora per ottenere maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per *life.augmented*.

Nel 2015, ST ha avuto ricavi netti pari a 6,90 miliardi di dollari presso più di 100 mila clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com.

Dichiarazioni su aspettative future

Alcune delle affermazioni contenute in questo comunicato comprese quelle relative ad applicazioni di prodotti e a prodotti futuri, sviluppi congiunti, attività di marketing o commerciali, potenziali opportunità di mercato e obiettivi, sono dichiarazioni su aspettative future che comprendono alcuni rischi e incertezze. Tra i fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in maniera sostanziale da quelli previsti nelle dichiarazioni su aspettative future relative a MicroVision vi sono: il rischio che dalle attività di co-marketing delle due parti non derivino miglioramenti del business, la capacità di MicroVision di ottenere capitale addizionale, se necessario; il fatto che i prodotti che integrano la tecnologia di scansione PicoP® di MicroVision possano non essere accettati dal mercato, il fatto che i partner commerciali ottengano dei risultati diversi da quelli previsti in base agli accordi, un eventuale insuccesso di MicroVision nell'identificare soggetti interessati nel pagare la somma o le somme che considera accettabili per l'acquisto o la licenza delle nostre proprietà intellettuali, l'insuccesso di MicroVision o dei suoi clienti nel rispettare gli ordini di acquisto aperti; le sue risorse tecniche e finanziarie rispetto a quelle dei concorrenti; la capacità di MicroVision di mantenere il passo con i rapidi cambiamenti tecnologici; le normative governative che hanno impatto sulla sua tecnologia; la capacità di MicroVision di far rispettare i suoi diritti di proprietà intellettuale e di proteggere le sue tecnologie proprietarie; la capacità di acquisire ulteriori contratti; la tempistica del lancio di prodotti commerciali ed eventuali ritardi nello sviluppo di prodotti, la capacità di rispettare i principali traguardi tecnici nei prodotti chiave, la dipendenza da terze parti per lo sviluppo, produzione, vendita e la commercializzazione dei suoi prodotti; potenziali problemi di responsabilità causati dai nostri prodotti; e altri fattori di rischio identificati di volta in volta nei rapporti depositati da MicroVision presso la SEC, compreso il suo bilancio annuale sul Modulo 10-K depositato presso la SEC. Con l'eccezione di quanto espressamente richiesto dalle leggi federali sulle società quotate in borsa, MicroVision non assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le nostre dichiarazioni su aspettative future, sia in seguito a nuove informazioni, eventi futuri, cambiamenti nelle circostanze o per qualunque altro motivo.

###

Per ulteriori informazioni, contattare:

MicroVision:

Dawn Goetter, ir@microvision.com, +1 425-882-6629 (investors)

Nicole Cobuzio, nicolec@lotus823.com, +1 732-212-0823 ext. 102 (media)

Relazioni con la stampa

Laura Sipala – Direttore relazioni pubbliche e con i media, Italia
+39.039.6035113 - STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com.

T3876D